



NC512 SAC305



Soldadura en Pasta No-Clean

Características:

- Reduce Defectos por Hundimientos
- Bajo Voids en OSP
- Mejora la Definición de Impresión Fina
- Compatible con Rheopump y DEK ProFlow
- Reduce el Graping
- Alta tolerancia a la Humedad

Descripción:

La NC512 es una soldadura en pasta no-clean que ha comprobado ofrecer excelente actividad y características de wetting, resistencia superior al slump y reducir voids en BGAs. La NC512 también ofrece alta tolerancia a la humedad y una química desarrollada para ser utilizada en equipos de reflujo por aire. La tolerancia al slump y a la humedad encontrada en la NC512 extiende la vida útil de las soldaduras en pasta en instalaciones donde el control ambiental no es óptimo. La NC512 también ofrece residuos suaves para pruebas eléctricas y compatibilidad con las libres de plomo.

Impresión:

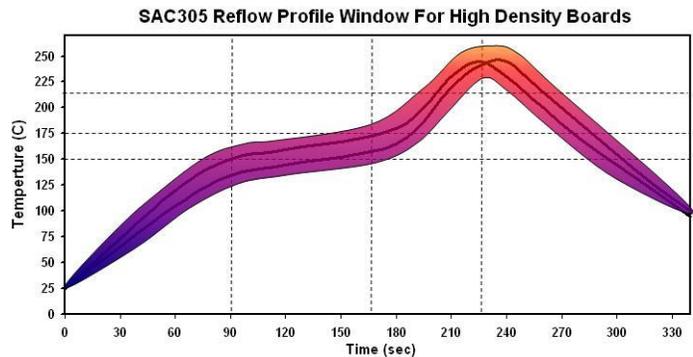
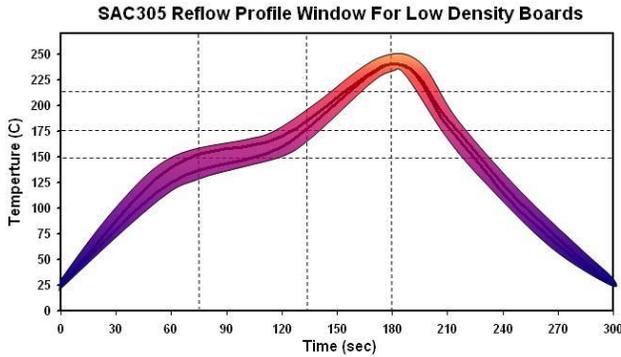
- Aplique suficiente pasta al stencil para permitir un movimiento suave y parejo durante el ciclo de impresión (una gota con un diámetro de 12 a 16 mm (½ to ⅝ pulgada) es normalmente suficiente para empezar)
- Aplique pequeñas cantidades de soldadura en pasta fresca al stencil a intervalos controlados para mantener la química y las propiedades de trabajo de la pasta.
- La NC512 ofrece el tiempo necesario de tack y fuerza para la alta velocidad del equipo de colocación moderno, que aumentará el desempeño y confiabilidad del producto.
- La limpieza del stencil variará por aplicación; sin embargo, puede lograrse utilizando el limpiador de stencil AIM DJAW-10.

LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DE LA IMPRESORA DEPENDE DEL DISEÑO DEL PCB Y DE LA PISTA

PARÁMETRO	CONFIGURACIÓN INICIAL RECOMENDADA	PARÁMETRO	CONFIGURACIÓN INICIAL RECOMENDADA
Presión de la Boquilla	0.9 – 1.5 kg/cm de la navaja	Distancia de Separación del PCB	0.75-2.0 mm (.030-.080")
Velocidad de la Boquilla	0.5 – 6 pulgadas/segundo	Velocidad de Separación del PCB	3.0 – 20.00 mm/segundo
Distancia de Desprendimiento	Al contacto 0.00 mm (0.00")		

Perfil de Reflujo:

Dos familias de perfil único se muestran a continuación; ambas pueden ser utilizadas en rampa de punta o aplicaciones en rampa remojo-pico y ambas tienen temperatura de reflujo similar. Ambos perfiles difieren en cuanto al punto en que alcanzan su temperatura pico así como el tiempo por sobre la licuefacción (TAL). El perfil más corto de las dos aplicaría para ensamblajes más pequeños, mientras que la de perfil mayor aplicaría a ensamblajes más grandes como los de las placas posteriores o tableros de alta densidad. El área sombreada define la ventana de proceso. La eficiencia del horno, tamaño/masa del tablero, tipo de componente y densidad, influyen todos en el perfil final para un ensamblaje dado. Estos perfiles son puntos de partida, y se recomiendan los tableros de proceso con coples térmicos anexos para optimizar el proceso.



<i>RAMPA DE PRE-CALENTAMIENTO</i> 2°C / SEC MAX	<i>RAMPA A</i> 150°C (302°F)	<i>PROGRESO A TRAVÉS DE</i> 150°C-175°C (302°F-347°F)	<i>A TEMP. PICO</i> 230°C- 245°C (445°F - 474°F)	<i>TIEMPO SOBRE</i> 217°C (425°F)	<i>ENFRIAMIENTO</i> ≤ 4 °C / SEC	<i>PERFIL DE DISTANCIA DE TEMP. AMBIENTE A ENFRIAMIENTO</i>
Perfiles Cortos	≤ 60 Sec	15-45 Sec	45-75 Sec	45-60 Sec	45± 15 Sec	2.75-3.75 Min
Perfiles Largos	≤ 90 Sec	60-90 Sec	45-60 Sec	45-75 Sec	45± 15 Sec	4.0-5.0 Min

❖ EL PERFIL DE REFLUJO RECOMENDADO PARA LA RMA258-15R SE OFRECE COMO GUÍA. EL PERFIL PUEDE DIFERIR EN BASE AL TIPO DE HORNO, FORMATO DE ENSAMBLE U OTRAS VARIABLES DEL PROCESO. PARA APOYO ADICIONAL CONTACTE A

Limpieza:

- La NC512 puede ser limpiada, en caso necesario, con agua con saponificador o con un limpiador solvente adecuado.
- Para una lista de materiales de limpieza adecuados, por favor refiérase al AIM cleaner matrix (Tabla de Limpiadores).

Manejo y Almacenaje:

- NC512 tiene una vida útil de 1 año cuando se almacena entre 4 °C y 12 °C (40 °F and 55 °F), y de tres meses cuando se almacena entre 13 °C and 22 °C (55 °F and 72 °F).
- Permita a la soldadura en pasta calentarse completa y naturalmente a temperatura ambiente (8 hrs.) antes de romper el sello para utilizarla.
- Mezcle el producto ligera y completamente (1-2 mins. max) para asegurar una distribución pareja de todo el material.
- No almacene pasta nueva y usada en el mismo contenedor, y vuelva a sellar cualquier envase abierto, mientras no esté en uso.
- Vuelva a colocar las tapas internas y externas del tarro de 500 gramos para asegurar el mejor sellado posible.

Propiedades Físicas:

<i>ITEM</i>	<i>ESPECIFICACIÓN</i>
Apariencia	Gris, Suave, Cremosa
Aleación	SAC305
Punto de Fusión	217°-218°C
Tamaño de las Partículas	T3, T4, T5
Viscosidad	Disponible en versión para Impresión y Despachador
Presentación	Disponible en todas las presentaciones estándares de la industria

Resumen de Datos de Prueba:

CLASIFICACIÓN			
Nombre del Producto	Clasificación IPC a J-STD-004	Espejo de Cobre a J-STD-004	Cromato de Plata a J-STD-004
NC512	ROL0	BAJO	PASA
EXAMEN DEL POLVO			
No.	Item	Resultados	Método de Prueba
1	Tamaño del Polvo	Tipo 3 – 45-25 micrones Tipo 4 – 38-20 micrones	IPC TM 650 2.2.14
2	Forma del Polvo	Esférica	Microscopio
PRUEBA MEDIA DEL FLUX			
No.	Item	Resultados	Método de Prueba
1	Valor Ácido	133.08 mg KOH/ g flux	J-STD-004 IPC TM 650 2.3.13
2	Contenido de Haluros	Papel de Cromato de Plata - Pasa	J-STD-004 IPC TM 650 2.3.35
3	Prueba de Mancha de Fluoruros	Sin fluoruro	J-STD-004 IPC TM 650 2.3.35.1 J-STD-004 IPC TM 650 2.3.35.2
4	Prueba de Corrosión/Espejo de Cobre	Baja	J-STD-004 IPC TM 650 2.6.15
5	Corrosión de Flux	Pasa	J-STD-004 IPC TM 650 2.3.33
6	Resistencia Aislante de la Superficie	Pasa – Ver Reporte de Calificación de AIM	J-STD-004 IPC TM 650 2.6.3.7
7	Bomba de Oxígeno	Bromina 639 mg/Kg Cloro <510 mg/Kg	EN 14582:2007 SW 9056 SW 5050
PRUEBA DE VISCOSIDAD			
No.	Item	Resultados	Método de Prueba
1	Método de Prueba del Eje de la Barra T	700 ± 10% kcps	J-STD-005 IPC TM 650 2.4.34
PRUEBA DE SOLDADURA EN PASTA			
No.	Item	Resultados	Método de Prueba
1	Prueba de Punto	40.0 g	J-STD-005 IPC TM 650 2.4.44
2	Prueba de Punto	102.6 g	JIS Z 3284 Anexo 9
3	Prueba de Bolas de Soldadura	Pasa	J-STD-005 IPC TM 650 2.4.43
4	Prueba de Wetting	Pasa	J-STD-005 IPC TM 650 2.4.45
5	Vida útil de la Pasta	Entre 4° y 12° C (40° y 55° F) = 6 meses	AIM TM 125-11
6	Prueba de Slump en Soldadura en Pasta	Pasa	J-STD-005 IPC TM 650 2.4.35

USA +1-401-463-5605 · Canadá +1-514-494-2000 · Europa +44-1737-222-258 · México +52-656-630-0032
Asia-Pacífico +86-755-2993-6487 · India +91-80-41554753 · info@aimsolder.com · www.aimsolder.com
AIM ESTA CERTIFICADA EN ISO 9001:2008 y ISO 14001: 2004

La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. Toda información sobre la soldadura en pasta es producida con polvo de 45 micrones. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms.cfm> para revisar términos y condiciones de AIM.